

## Pressemitteilung

Hanau, 05.06.2018

### **Primetime für die Leistungselektronik: Heraeus Electronics präsentiert das neue Metall-Keramik-Substrat Condura.prime**

Heraeus Electronics, ein führender Anbieter von Materiallösungen für die Halbleiter- und Elektronikindustrie, präsentiert auf der PCIM in Nürnberg das neue Metall-Keramik-Substrat Condura.prime (AMB-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>) sowie die zugehörige Substratfamilie Condura.

#### **E-Mobilität treibt die Nachfrage nach Leistungselektronik an**

Das Premium-Produkt Condura.prime ist ein AMB-Siliziumnitrid-Substrat (Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>), das im Vergleich zu anderen Metall-Keramik-Substraten eine Vielzahl von Vorteilen bietet. Es ist mit ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften ausgestattet, die eine hohe Biege- und Bruchfestigkeit gewährleisten. Darüber hinaus bietet Condura.prime eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit und ist ideal für Leistungselektronikmodule in Automobil, Energie- und Traktionsanwendungen.

Leistungselektronische Module werden insbesondere für den wachsenden Markt der Elektromobilität benötigt. Mit einer zunehmenden Anzahl von Hybrid- und Elektrofahrzeugen erwartet die Industrie effiziente und zuverlässige leistungselektronische Komponenten zu niedrigen Kosten. Metall-Keramik-Substrate, die in allen elektrischen Antriebssträngen eingesetzt werden, spielen hier eine Schlüsselrolle.

#### **Condura - eine neue Familie von Metall-Keramik-Substraten**

Die Condura-Familie besteht aus Condura.classic (DCB-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), dem bewährten Standard für die Leistungselektronik, Condura.extra (DCB-ZTA) mit verstärkter mechanischer Stabilität zur Verbesserung der Modulzuverlässigkeit und Verarbeitbarkeit sowie dem Top-Produkt Condura.prime (AMB-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>).

#### **Services über das Produkt hinaus**

Neben den Produkten der Condura-Familie bietet Heraeus attraktive Optionen und Dienstleistungen über das Produkt hinaus an. Um die Produktionsausbeute zu verbessern, Produktionsrisiken zu reduzieren und Reinigungsschritte zu vermeiden, können Condura-Substrate mit vorapplizierten, flussmittelfreien Lotdepots für die Chipplötung angeliefert werden. Dadurch wird die Anzahl der Prozessschritte für den Die-Attach um die Hälfte reduziert und der Lötprozess erheblich vereinfacht.

Heraeus Electronics ist nach IATF-16949-Standard als Lieferant für die Automobilindustrie zertifiziert und präsentiert sich als zuverlässige Second-

Source für Metall-Keramik-Substrate. Engineering Services inklusive Simulation, Prototypen-Design und Herstellung sowie Tests und Analysen machen Heraeus Electronics zum Lösungsanbieter für alle Leistungselektronik-Anwendungen.

---

## **Über Heraeus**

Der Technologiekonzern Heraeus mit Sitz in Hanau ist ein weltweit führendes Portfoliounternehmen in Familienbesitz. Die Wurzeln des 1851 gegründeten Unternehmens reichen zurück auf eine seit 1660 von der Familie betriebene Apotheke. Heraeus bündelt heute eine Vielzahl von Geschäften in den Feldern Umwelt, Energie, Elektronik, Gesundheit, Mobilität und industrielle Anwendungen.

Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Heraeus einen Gesamtumsatz von 21,8 Mrd. €. Das im FORTUNE Global 500 gelistete Unternehmen beschäftigt rund 13.000 Mitarbeiter in 40 Ländern und hat eine führende Position auf seinen globalen Absatzmärkten. Heraeus gehört zu den Top 10 Familienunternehmen in Deutschland.

Mit fachlicher Kompetenz, Exzellenz sowie der Ausrichtung auf Innovationen und eine unternehmerisch geprägte Führungskultur streben wir danach, unsere Leistungsfähigkeit kontinuierlich zu verbessern. Für unsere Kunden schaffen wir hochwertige Lösungen und stärken nachhaltig ihre Wettbewerbsfähigkeit, indem wir einzigartige Material-Kompetenz mit Technologieführerschaft verbinden.

## **Über Heraeus Electronics**

Heraeus Electronics - eine globale Business Unit des Heraeus Konzerns - ist einer der führenden Hersteller von Materialien für die Aufbau- und Verbindungstechnik in der Elektronikindustrie. Das Unternehmen entwickelt anspruchsvolle Materiallösungen für Consumer Electronics und Computing, die Automobilindustrie, LED-Technik, Leistungselektronik und Communications. Zu den Kernkompetenzen zählen Bonddrähte, Assembly Materialien, Dickfilmpasten, walzplattierte Bänder und Substrate sowie deren Integration in passend aufeinander abgestimmte Systeme.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Morvyn Lipinski  
Manager Media Relations  
Communications & Marketing  
Heraeus Holding GmbH  
Telefon +49 61 81 35-97 93  
E-Mail [morvyn.lipinski@heraeus.com](mailto:morvyn.lipinski@heraeus.com)